

注) NOTES

- 材質 MATERIAL  
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0  
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0  
ターミナル: リン青銅  
TERM.: PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様 PLATING  
接点部: 金メッキ、表参照  
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE  
半田付け部: 錫メッキ 1.0µmMIN.  
SOLDER AREA: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.  
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.  
UNDERPLATE: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM.
- 推奨基板厚: t=1.6±0.05  
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
- 金メッキ厚標示  
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING  
黄色: 0.1µmMIN.  
YELLOW: 0.1 MICROMETER MINIMUM.  
緑色: 0.38µmMIN.  
GREEN: 0.38 MICROMETER MINIMUM.  
オレンジ色: 0.76µmMIN.  
ORANGE: 0.76 MICROMETER MINIMUM.  
無色: 1.27µmMIN.  
UNMARKED: 1.27 MICROMETER MINIMUM.
- ハウジングの色は、グレイ。  
HOUSING COLOR IS GRAY.
- 本製品は52018-4\*\*5の鉛フリー品である。  
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52018-4\*\*5.

後番号 -42\*6に適用  
MATERIAL NO. SUFFIX -42\*6

基板穴推奨寸法  
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT  
(ジャック取付け側)  
(JACK ASS'Y SIDE)

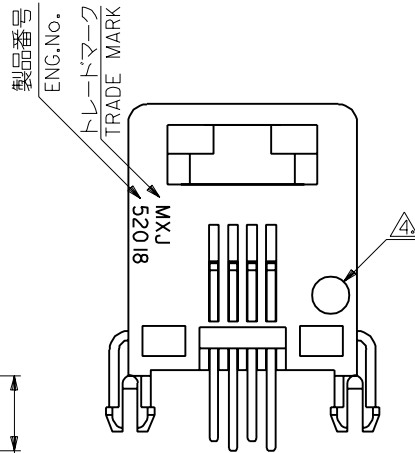
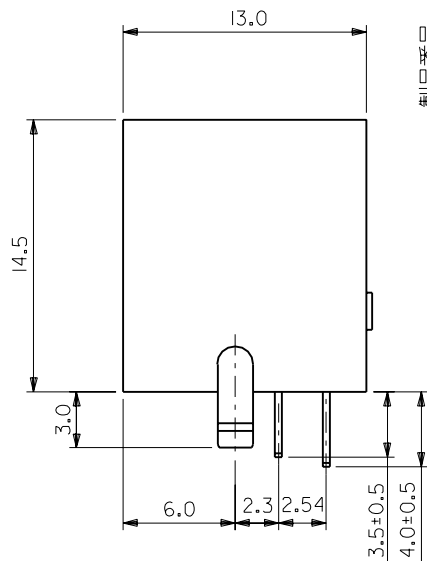
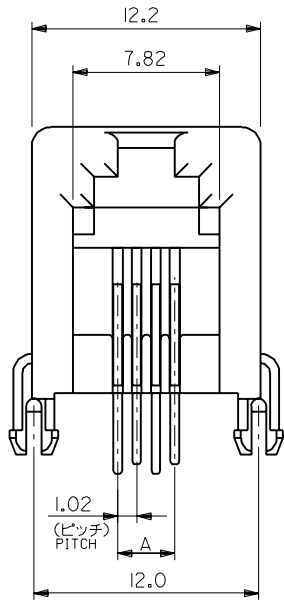
後番号 -44\*6に適用  
MATERIAL NO. SUFFIX -44\*6

4	4	3.05	1.27	52018-4446
			0.76	-4436
			0.38	-4426
			0.1	-4416
4	2	1.02	1.27	52018-4246
ポジション POSITION	極数 CIRCUITS	(A)	金メッキ厚 (µmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.) (µmMIN.)	製品番号 MATERIAL NO.

64 NO. DRWN: CHK: APPR:	63 NO. DRWN: CHK: APPR:	62 NO. DRWN: CHK: APPR:	61 NO. DRWN: CHK: APPR:	新製/作成 RELEASED 0 DRWN: M.NAGATA '04/05/13 CH'K: K.TOJO '04/05/13 APPR: M.SASAO '04/05/13	MATERIAL 材料 注参照 SEE NOTES	GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差 10 UNDER 未満 ±0.2 10 OVER 30 UNDER 未満 ±0.25 30 OVER 以上 ±0.3 ANGLE 角度 ±3°	SCALE 4:1 DESIGN UNITS <input checked="" type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> INCH PROJECTION <input checked="" type="checkbox"/> FIRST ANGLE <input type="checkbox"/> THIRD ANGLE	MODEL NO. 52018-4**6 DIMENSIONS: <input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> INCH <input type="checkbox"/> mm ONLY <input checked="" type="checkbox"/> mm ONLY	SHT 1 OF 1 REV B	DRAWN BY & DATE M.NAGATA '04/05/13 CHECKED BY & DATE K.TOJO '04/05/13 APPROVED BY & DATE M.SASAO '04/05/13	TITLE: MODULAR JACK HOUSING ASS'Y -LEAD FREE- MOLEX MOLEX INCORPORATED	CAD FILENAME SD-52018-002.S01	MATERIAL NO. SEE CHART DRAWING NO. SD-52018-002 SHEET NO. 1 OF 1	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	SIZE B

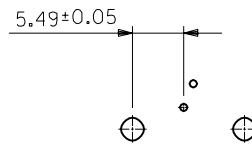
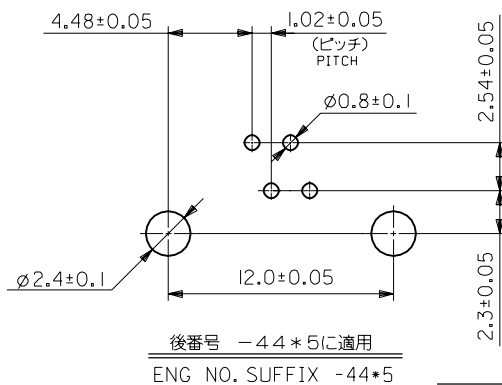
ENG. NO. SD-52018-4\*\*5

OSAI.HI.I10.31552018G4.DGN | DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



注) NOTES

- 材質 MATERIAL  
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL 94V-0  
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0  
ターミナル: リン青銅  
TERM.: PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様 PLATING  
接点部: 金メッキ、表参照  
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE  
半田付け部: 半田メッキ 1.0 μmMIN.  
SOLDER AREA: TIN-LEAD 1.0 μmMIN.  
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0 μmMIN.  
UNDERPLATE: NICKEL 1.0 μmMIN.
- 推奨基板厚: t=1.6±0.05  
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
- 金メッキ厚標示  
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING  
黄色: 0.1 μmMIN.  
YELLOW: 0.1 μmMIN.  
緑色: 0.38 μmMIN.  
GREEN: 0.38 μmMIN.  
オレンジ色: 0.76 μmMIN.  
ORANGE: 0.76 μmMIN.  
無色: 1.27 μmMIN.  
UNMARKED: 1.27 μmMIN.
- ハウジングの色は、グレイ。  
HOUSING COLOR IS GRAY.



後番号 -42\*5に適用  
ENG NO. SUFFIX -42\*5

後番号 -44\*5に適用  
ENG NO. SUFFIX -44\*5

基板穴推奨寸法  
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT  
(ジャック取付け側)  
(JACK ASS'Y SIDE)

角度 ANGLE	+3°
30以上 OVER	+0.3
10以上 30未満 UNDER	+0.25
10未満 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注及び表参照 SEE NOTES AND CHART
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY '96/3/8	CHK'D BY '96/8/29
K.HARADA	M.F.FUKUSHIMA
APP'D BY '96/8/29	尺度 SCALE 4-1
M.FUKUSHIMA	

4	4	3.05	1.27	52018-4445
			0.76	-4435
			0.38	-4425
			0.1	-4415
4	2	1.02	1.27	52018-4245
ポジション POSITION	極数 CIRCUITS	(A)	金メッキ厚 (μmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.) (μmMIN.)	製品番号 ENG. No.

材料 MATERIAL		注参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		注及び表参照 SEE NOTES AND CHART		EDP. NO. —	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—		ENG. NO. SD-52018-4**5	
被覆外径 INS. RANGE		—		REV C	
DRAWN BY '96/3/8		CHK'D BY '96/8/29		TITLE 名称 MODULAR JACK HOUSING ASS'Y	
K.HARADA		M.F.FUKUSHIMA			
APP'D BY '96/8/29		尺度 SCALE 4-1			
M.FUKUSHIMA					

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むので、当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Molex](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[RJE231881317T](#) [MP1010RX-1000](#) [MP44RX-1000](#) [GAX-3-66](#) [GAX-8-62](#) [93606-0253](#) [GD-A-44](#) [GDCX-PA-66-50](#) [GDCX-PN-64](#) [GDCX-PN-66](#) [GDCX-PN-66-50](#) [GDLX-A-66](#) [GDLX-A-88](#) [GDLX-N-66](#) [GDLX-S-88K](#) [GDTX-S-88-50](#) [GDX-PA-1010](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-N-44M](#) [GLX-S-88M-BLK](#) [GMX-N-1010](#) [GMX-S-1010](#) [GMX-S-66](#) [GMX-SMT2-N-1010](#) [GMX-SMT2-N-64-50](#) [GMX-SMT2-S6-88](#) [GMX-SMT4-N-88](#) [GPX-2-64](#) [GRT1-BT1-5](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS2-88-3.05-50](#) [GSX-NS-88-3.05-30](#) [GSX-NS-88-3.05-50](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [1-1775629-2](#) [GWLX-S-88-GR](#) [GWLX-S9-88-YG](#) [1300500326](#) [1300500227](#) [1300530003](#) [1300570002](#) [1324640-4](#) [RJ11FTVC2G](#) [RJ11FTVC2N](#) [RJFTVX2SA1G](#) [132764-001](#) [1400000](#) [1413176](#) [1413235](#)